

■ 許容損失について (DFN1616-6)

DFN1616-6パッケージの許容損失について特性例を示します。

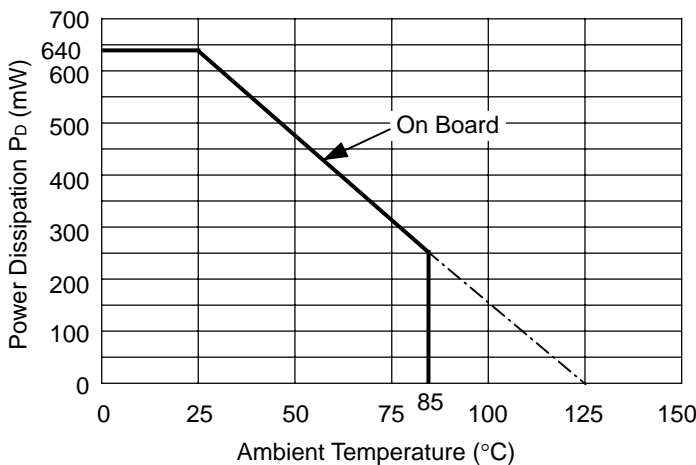
なお、許容損失は実装条件に左右されますので、本特性例は下記測定条件での参考データとなります。

測定条件

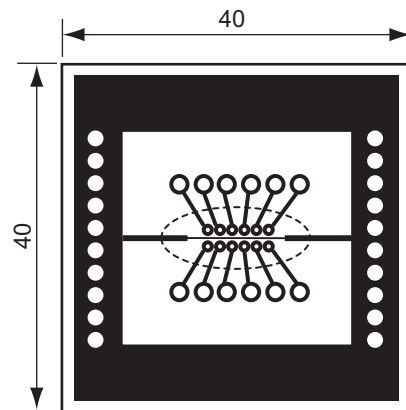
	標準実装条件
測定状態	基板実装状態 (風速 0m/s)
基板材質	ガラスエポキシ樹脂 (両面基板)
基板サイズ	40mm × 40mm × 1.6mm
配線率	表面 約 50%、裏面 約 50%
スルーホール	直径 0.5mm × 32 個

測定結果 (Topt=25°C, Tjmax=125°C)

	標準実装条件
許容損失	640mW
熱抵抗値	$\theta_{ja} = (125-25^\circ\text{C})/0.64\text{W} = 156^\circ\text{C/W}$
熱抵抗値	$\theta_{jc} = 23^\circ\text{C/W}$



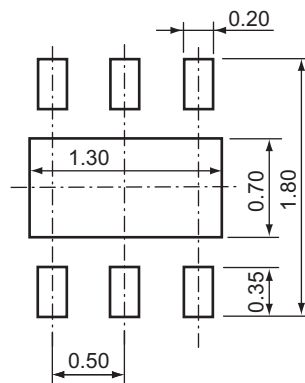
許容損失特性



測定用基板レイアウト

○ IC 実装位置 (単位 : mm)

■ 基板パッド推奨寸法 (DFN1616-6)



(単位 : mm)